

中国半导体划片机行业现状深度研究与投资前景 分析报告（2025-2032年）

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《中国半导体划片机行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202509/765580.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sales@chinabaogao.com

联系人：客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，页面图表可能存在缺失；格式美观性可能有欠缺，实际报告排版规则、美观；可联系客服索取更完整的目录大纲。

二、报告目录及图表目录

前言：

作为决定芯片最终良率的“封测关键手术刀”，半导体划片机在封测环节中占据约28%的份额。随着国内半导体产能的持续扩建及先进封装需求的爆发，划片机市场迎来强劲增长。然而，该领域长期被海外巨头垄断，国产设备正凭借政策支持、成本优势及本土化服务，沿着从成熟制程到第三代半导体的路径奋力追赶，一场深刻的国产化替代浪潮已然开启。

1、半导体划片机是半导体封装设备的核心

划片机是半导体芯片制造后道工序——封装测试环节中的关键设备，它的作用是将完成前道工艺、制作有成千上万颗芯片的整片晶圆，按照芯片单元进行切割分离，成为独立的晶粒。按照技术来看，半导体划片机主要分为刀片切割、激光切割。

半导体划片机技术分类

资料来源：观研天下整理

切割的精度、崩边尺寸、切割效率直接影响到芯片的良率和性能，一旦切割失误，将导致前道所有工艺的价值损失。根据相关资料，2025年，全球半导体封装设备市场规模有望达417亿元，其中固晶机（贴片机）占比30%，划片机（切片机）占比28%，键合机占比23%。

数据来源：观研天下整理

2、半导体产能不断扩建，驱动划片机行业需求上升

而随着芯片尺寸越来越小、晶圆越来越薄，对划片精度和工艺的要求也愈发严苛。近年来，无论是晶圆厂还是封测厂，都在积极扩产，直接拉动了对划片机等封装设备的需求。

截至2025年9月我国半导体在建、扩建项目汇总

项目名称

相关企业

地点

主要内容/产能目标

当前状态

武汉碳化硅半导体基地

长飞先进

湖北武汉

年产36万片6英寸碳化硅晶圆

已正式投产

8英寸碳化硅功率器件芯片生产线

士兰微（士兰集宏）

福建厦门

一期年产42万片8英寸碳化硅芯片

一期项目已封顶，进入装修安装阶段

8英寸SiC芯片生产线

三安光电（湖南三安）

湖南

年产48万片8英寸碳化硅晶圆

已投产

重庆碳化硅晶圆厂

三安光电&意法半导体

重庆

每周约1万片汽车级碳化硅晶圆

完成调试，预计2025年四季度量产

八英寸新型电力电子器件基地（二期）

华微电子

吉林

新增月产能3万片8英寸IGBT、MOSFET芯片

设备安装调试中，预计2025年四季度产能爬坡

先进功率器件封装基地

华微电子

吉林

年产15亿只功率器件及模块

三期滚动建设中，大功率模块线预计2026年上半年达产

宽禁带半导体中试线

华微电子

吉林

6英寸SiC（碳化硅）和GaN（氮化镓）器件

已开始客户验证，计划2026年转入量产

华南总部研发及生产基地

中微公司

广东广州

大平板显示设备等

已开工建设，预计2027年投产

半导体研发生产项目

金源半导体

湖北鄂州

半导体设备关键耗材与零部件

已开工建设

资料来源：观研天下整理

同时，Fan-Out（扇出型）、2.5D/3D等先进封装技术对划片工艺提出了更高要求，推动了高端激光划片机的需求。

3、国产半导体划片机水平仍然较低，细分市场机会再现

不过，国产半导体切片机在切割精度、稳定性、稼动率、耗材寿命等核心指标上，与DISCO等相比仍有代际差，高端主轴、激光器等核心部件仍依赖进口。而且半导体产线对设备稳定性要求极高，导入新设备需要漫长的验证周期（通常1-2年），客户转换成本高、意愿谨慎。

当前，国产划片机在LED、分立器件、电源管理芯片等对精度要求相对较低的成熟制程领域，已具备一定替代能力，并开始进入国内主流封测厂（如长电科技、通富微电、华天科技）的产线进行验证和试用。但在CPU、GPU、高端手机芯片等超精密划片领域，仍与DISCO有较大差距。

国产半导体划片机主要企业技术突破及市场布局策略

企业代表

技术特长与突破

市场布局策略

主要进展与客户

中国电科（CETC）45所

全自动精密划片机，同时在刀片切割和激光切割领域有深厚积累，具备国家队的研发实力和可靠性。

全面替代：覆盖从LED、分立器件到IC封装的全领域。重点攻关国内主流封测厂和晶圆厂。已进入长电科技、通富微电、华天科技等国内三大封测龙头供应链，进行验证和批量应用。

苏州迈为股份

凭借在光伏激光设备领域的强大技术底蕴，跨界进入半导体划片机市场，在激光应用方面有独特优势。

聚焦增量与高端：重点瞄准第三代半导体（SiC、GaN）和先进封装所需的激光划片机市场。

进展迅速，其激光开槽设备等已获得头部客户订单，展现出强大的市场冲击力。

沈阳芯源微

以其在涂胶显影设备上的优势为支点，向前道（如临时键合）和后道（如划片）工艺设备延伸。

协同销售：利用其现有客户资源，提供前后道协同的解决方案，捆绑销售。

其划片机产品已在部分客户生产线上进行验证。

其他专业公司（如上海微高、北京科创源等）

专注于某一特定技术或市场，如专攻超薄晶圆划片或专用材料划片。

利基市场：先在特定细分领域（如功率半导体、MEMS传感器）做深做透，建立口碑。

在各自细分领域拥有稳定的客户群，是国产化的重要补充力量。

资料来源：观研天下整理

然而，我国半导体划片机行业拥有前所未有的政策与资金支持，如国家“大基金”及地方基金对半导体设备产业链的支持力度空前，并且国产厂商凭借着本土化服务优势，可以提供更快速、更贴近的客户服务和工艺支持，响应速度快，而国产设备在采购和维护成本上具备显著优势，有助于下游厂商降低资本开支。综上，我国半导体划片机行业未来发展趋势如下：

我国半导体划片机行业未来发展趋势

趋势

简析

激光技术应用深化

对于超薄晶圆和第三代半导体材料（如SiC、GaN），激光隐形切割成为必然选择，技术门槛更高。

智能化与自动化

集成机器视觉、AI算法进行自动定位、缺陷检测和工艺参数优化，提升设备稳定性和产出效率。

替代路径清晰

国产替代将沿着“低端替代→中端渗透→高端突破”的路径逐步推进。当前正处于从中低端向中高端渗透的关键期。

细分市场机遇

SiC、GaN器件的切割是新兴市场，国内外起步差距相对较小，国产设备有换道超车的机会。

成熟制程产能配套

中国在模拟芯片、功率半导体等成熟制程的产能建设力度很大，为国产划片机提供了广阔的存量替代和增量市场空间。

产业链协同

划片机的性能不仅取决于设备本身，还与刀片、吸嘴、冷却液等耗材，以及具体的切割工艺配方紧密相关。国内厂商需要建立起完整的工艺解决方案能力，而不仅仅是销售单台设备。

资料来源：观研天下整理（WYD）

注：上述信息仅供参考，图表均为样式展示，具体数据、坐标轴与数据标签详见报告正文。

个别图表由于行业特性可能会有出入，具体内容请联系客服确认，以报告正文为准。

更多图表和内容详见报告正文。

观研报告网发布的《中国半导体划片机行业现状深度研究与投资前景分析报告（2025-2032年）》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。

本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

行业报告是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。

本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

目录大纲：

【第一部分 行业定义与监管】

第一章 2020-2024年中国 半导体划片机 行业发展概述

第一节 半导体划片机 行业发展情况概述

一、 半导体划片机 行业相关定义

二、 半导体划片机 特点分析

三、 半导体划片机 行业基本情况介绍

四、 半导体划片机 行业经营模式

（1）生产模式

（2）采购模式

（3）销售/服务模式

五、 半导体划片机 行业需求主体分析

第二节 中国 半导体划片机 行业生命周期分析

一、 半导体划片机 行业生命周期理论概述

二、 半导体划片机 行业所属的生命周期分析

第三节 半导体划片机 行业经济指标分析

一、 半导体划片机 行业的赢利性分析

二、 半导体划片机 行业的经济周期分析

三、 半导体划片机 行业附加值的提升空间分析

第二章 中国	半导体划片机	行业监管分析	
第一节 中国	半导体划片机	行业监管制度分析	
一、	行业主要监管体制		
二、	行业准入制度		
第二节 中国	半导体划片机	行业政策法规	
一、	行业主要政策法规		
二、	主要行业标准分析		
第三节 国内监管与政策对	半导体划片机	行业的影响分析	
【第二部分 行业环境与全球市场】			
第三章 2020-2024年中国	半导体划片机	行业发展环境分析	
第一节 中国宏观环境与对	半导体划片机	行业的影响分析	
一、	中国宏观经济环境		
二、	中国宏观经济环境对	半导体划片机	行业的影响分析
第二节 中国社会环境与对	半导体划片机	行业的影响分析	
第三节 中国对外贸易环境与对	半导体划片机	行业的影响分析	
第四节 中国	半导体划片机	行业投资环境分析	
第五节 中国	半导体划片机	行业技术环境分析	
第六节 中国	半导体划片机	行业进入壁垒分析	
一、	半导体划片机	行业资金壁垒分析	
二、	半导体划片机	行业技术壁垒分析	
三、	半导体划片机	行业人才壁垒分析	
四、	半导体划片机	行业品牌壁垒分析	
五、	半导体划片机	行业其他壁垒分析	
第七节 中国	半导体划片机	行业风险分析	
一、	半导体划片机	行业宏观环境风险	
二、	半导体划片机	行业技术风险	
三、	半导体划片机	行业竞争风险	
四、	半导体划片机	行业其他风险	
第四章 2020-2024年全球	半导体划片机	行业发展现状分析	
第一节 全球	半导体划片机	行业发展历程回顾	
第二节 全球	半导体划片机	行业市场规模与区域分 布	情况
第三节 亚洲	半导体划片机	行业地区市场分析	
一、	亚洲	半导体划片机	行业市场现状分析
二、	亚洲	半导体划片机	行业市场规模与市场需求分析
三、	亚洲	半导体划片机	行业市场前景分析

第四节 北美	半导体划片机	行业地区市场分析	
一、北美	半导体划片机	行业市场现状分析	
二、北美	半导体划片机	行业市场规模与市场需求分析	
三、北美	半导体划片机	行业市场前景分析	
第五节 欧洲	半导体划片机	行业地区市场分析	
一、欧洲	半导体划片机	行业市场现状分析	
二、欧洲	半导体划片机	行业市场规模与市场需求分析	
三、欧洲	半导体划片机	行业市场前景分析	
第六节 2025-2032年全球	半导体划片机	行业分布	走势预测
第七节 2025-2032年全球	半导体划片机	行业市场规模预测	
【第三部分 国内现状与企业案例】			
第五章 中国	半导体划片机	行业运行情况	
第一节 中国	半导体划片机	行业发展状况情况介绍	
一、	行业发展历程回顾		
二、	行业创新情况分析		
三、	行业发展特点分析		
第二节 中国	半导体划片机	行业市场规模分析	
一、影响中国	半导体划片机	行业市场规模的因素	
二、中国	半导体划片机	行业市场规模	
三、中国	半导体划片机	行业市场规模解析	
第三节 中国	半导体划片机	行业供应情况分析	
一、中国	半导体划片机	行业供应规模	
二、中国	半导体划片机	行业供应特点	
第四节 中国	半导体划片机	行业需求情况分析	
一、中国	半导体划片机	行业需求规模	
二、中国	半导体划片机	行业需求特点	
第五节 中国	半导体划片机	行业供需平衡分析	
第六节 中国	半导体划片机	行业存在的问题与解决策略分析	
第六章 中国	半导体划片机	行业产业链及细分市场分析	
第一节 中国	半导体划片机	行业产业链综述	
一、	产业链模型原理介绍		
二、	产业链运行机制		
三、	半导体划片机	行业产业链图解	
第二节 中国	半导体划片机	行业产业链环节分析	
一、	上游产业发展现状		

二、上游产业对	半导体划片机	行业的影响分析
三、下游产业发展现状		
四、下游产业对	半导体划片机	行业的影响分析
第三节 中国	半导体划片机	行业细分市场分析
一、细分市场一		
二、细分市场二		
第七章 2020-2024年中国	半导体划片机	行业市场竞争分析
第一节 中国	半导体划片机	行业竞争现状分析
一、中国	半导体划片机	行业竞争格局分析
二、中国	半导体划片机	行业主要品牌分析
第二节 中国	半导体划片机	行业集中度分析
一、中国	半导体划片机	行业市场集中度影响因素分析
二、中国	半导体划片机	行业市场集中度分析
第三节 中国	半导体划片机	行业竞争特征分析
一、企业区域分布特征		
二、企业规模分 布	特征	
三、企业所有制分布特征		
第八章 2020-2024年中国	半导体划片机	行业模型分析
第一节 中国	半导体划片机	行业竞争结构分析（波特五力模型）
一、波特五力模型原理		
二、供应商议价能力		
三、购买者议价能力		
四、新进入者威胁		
五、替代品威胁		
六、同业竞争程度		
七、波特五力模型分析结论		
第二节 中国	半导体划片机	行业SWOT分析
一、SWOT模型概述		
二、行业优势分析		
三、行业劣势		
四、行业机会		
五、行业威胁		
六、中国	半导体划片机	行业SWOT分析结论
第三节 中国	半导体划片机	行业竞争环境分析（PEST）
一、PEST模型概述		

二、政策因素

三、经济因素

四、社会因素

五、技术因素

六、PEST模型分析结论

第九章 2020-2024年中国 半导体划片机 行业需求特点与动态分析

第一节 中国 半导体划片机 行业市场动态情况

第二节 中国 半导体划片机 行业消费市场特点分析

一、需求偏好

二、价格偏好

三、品牌偏好

四、其他偏好

第三节 半导体划片机 行业成本结构分析

第四节 半导体划片机 行业价格影响因素分析

一、供需因素

二、成本因素

三、其他因素

第五节 中国 半导体划片机 行业价格现状分析

第六节 2025-2032年中国 半导体划片机 行业价格影响因素与走势预测

第十章 中国 半导体划片机 行业所属行业运行数据监测

第一节 中国 半导体划片机 行业所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国 半导体划片机 行业所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国 半导体划片机 行业所属行业财务指标分析

一、行业盈利能力分析

二、行业偿债能力分析

三、行业营运能力分析

四、行业发展能力分析

第十一章 2020-2024年中国 半导体划片机 行业区域市场现状分析

第一节 中国 半导体划片机	行业区域市场规模分析
一、影响 半导体划片机	行业区域市场分布 的因素
二、中国 半导体划片机	行业区域市场分布
第二节 中国华东地区 半导体划片机	行业市场分析
一、华东地区概述	
二、华东地区经济环境分析	
三、华东地区 半导体划片机	行业市场分析
（1）华东地区 半导体划片机	行业市场规模
（2）华东地区 半导体划片机	行业市场现状
（3）华东地区 半导体划片机	行业市场规模预测
第三节 华中地区市场分析	
一、华中地区概述	
二、华中地区经济环境分析	
三、华中地区 半导体划片机	行业市场分析
（1）华中地区 半导体划片机	行业市场规模
（2）华中地区 半导体划片机	行业市场现状
（3）华中地区 半导体划片机	行业市场规模预测
第四节 华南地区市场分析	
一、华南地区概述	
二、华南地区经济环境分析	
三、华南地区 半导体划片机	行业市场分析
（1）华南地区 半导体划片机	行业市场规模
（2）华南地区 半导体划片机	行业市场现状
（3）华南地区 半导体划片机	行业市场规模预测
第五节 华北地区 半导体划片机	行业市场分析
一、华北地区概述	
二、华北地区经济环境分析	
三、华北地区 半导体划片机	行业市场分析
（1）华北地区 半导体划片机	行业市场规模
（2）华北地区 半导体划片机	行业市场现状
（3）华北地区 半导体划片机	行业市场规模预测
第六节 东北地区市场分析	
一、东北地区概述	
二、东北地区经济环境分析	
三、东北地区 半导体划片机	行业市场分析

（1）东北地区	半导体划片机	行业市场规模	
（2）东北地区	半导体划片机	行业市场现状	
（3）东北地区	半导体划片机	行业市场规模预测	
第七节 西南地区市场分析			
一、西南地区概述			
二、西南地区经济环境分析			
三、西南地区	半导体划片机	行业市场分析	
（1）西南地区	半导体划片机	行业市场规模	
（2）西南地区	半导体划片机	行业市场现状	
（3）西南地区	半导体划片机	行业市场规模预测	
第八节 西北地区市场分析			
一、西北地区概述			
二、西北地区经济环境分析			
三、西北地区	半导体划片机	行业市场分析	
（1）西北地区	半导体划片机	行业市场规模	
（2）西北地区	半导体划片机	行业市场现状	
（3）西北地区	半导体划片机	行业市场规模预测	
第九节 2025-2032年中国	半导体划片机	行业市场规模区域分布	预测
第十二章	半导体划片机	行业企业分析（随数据更新可能有调整）	
第一节 企业一			
一、企业概况			
二、主营产品			
三、运营情况			
（1）主要经济指标情况			
（2）企业盈利能力分析			
（3）企业偿债能力分析			
（4）企业运营能力分析			
（5）企业成长能力分析			
四、公司优势分析			
第二节 企业二			
一、企业概况			
二、主营产品			
三、运营情况			
（1）主要经济指标情况			
（2）企业盈利能力分析			

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第三节 企业三

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第四节 企业四

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第五节 企业五

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第六节 企业六

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第七节 企业七

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第八节 企业八

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第九节 企业九

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

第十节 企业十

一、企业概况

二、主营产品

三、运营情况

(1) 主要经济指标情况

(2) 企业盈利能力分析

(3) 企业偿债能力分析

(4) 企业运营能力分析

(5) 企业成长能力分析

四、公司优势分析

【第四部分 展望、结论与建议】

第十三章 2025-2032年中国 半导体划片机 行业发展前景分析与预测

第一节 中国 半导体划片机 行业未来发展前景分析

一、中国 半导体划片机 行业市场机会分析

二、中国 半导体划片机 行业投资增速预测

第二节 中国 半导体划片机 行业未来发展趋势预测

第三节 中国 半导体划片机 行业规模发展预测

一、中国 半导体划片机 行业市场规模预测

二、中国 半导体划片机 行业市场规模增速预测

三、中国 半导体划片机 行业产值规模预测

四、中国 半导体划片机 行业产值增速预测

五、中国 半导体划片机 行业供需情况预测

第四节 中国 半导体划片机 行业盈利走势预测

第十四章 中国 半导体划片机 行业研究结论及投资建议

第一节 观研天下中国 半导体划片机 行业研究综述

一、行业投资价值

二、行业风险评估

第二节 中国 半导体划片机 行业进入策略分析

一、目标客户群体

二、细分市场选择

三、区域市场的选择

第三节	半导体划片机	行业品牌营销策略分析
一、	半导体划片机	行业产品策略
二、	半导体划片机	行业定价策略
三、	半导体划片机	行业渠道策略
四、	半导体划片机	行业推广策略
第四节	观研天下分析师投资建议	

详细请访问：<https://www.chinabaogao.com/baogao/202509/765580.html>